JMS技術講演会のご案内

低誘電・低損失材料の技術・開発動向
～AI・次世代通信が牽引する高速・高周波材料革新～

■講演会趣旨

低誘電・低損失材料の技術・開発動向について解説して頂くことによって、関連業界の方々の今後の事業に役立てていただくことを目的とします。

日時	2026年12月8日　火曜日　9:55～16:20 （予定）
	Webセミナー（Zoomウェビナーによるライブ配信）
聴講料	66,000円（税込）／1名 （テキストを含む）
定員	50名
主催	株式会社　ジャパンマーケティングサーベイ 東京都中央区東日本橋2-24-12　東日本橋槇町ビル Tel：03-5829-3891 ホームページURL　https://www.jms21.co.jp/

■講師/タイムテーブル

時間	テーマ	講演企業/講師
9:55～10:00	接続確認・諸連絡	
10:00～12:00	高周波基板材料に求められる特性と材料設計、 技術開発事例及び開発動向	川辺高分子研究所　代表　工学博士 川辺 正直　氏
12:00～13:00	休憩	
13:00～14:00	ミリ波通信モジュール用 基板材料 およびパッケージング技術	株式会社村田製作所　技術・事業開発本部 設計プロセス開発部 プリンシパルリサーチャー　博士（工学） 須藤　薫　氏
14:00～14:10	インターバルタイム	
14:10～15:10	高速・高周波基板向け 低誘電ポリイミド樹脂の 開発動向	荒川化学工業株式会社　事業本部 ファイン・エレクトロニクス事業部 エレクトロニクス部門 田﨑　崇司　氏
15:10～15:20	インターバルタイム	
15:20～16:20	パッケージ基板向け 熱硬化性樹脂の 低誘電化技術動向	三菱ケミカル株式会社 情報電子技術開発本部　情電技術部 半導体後工程グループ　絶縁材セクション セクションリーダー/主幹研究員 高橋　淳　氏

※各講演時間に5分程度の質疑応答を含みます。

■講演内容

1. 高周波基板材料に求められる特性と材料設計、技術開発事例及び開発動向　（川辺　正直　氏）

1. プリント基板の高周波対応をめぐる技術動向
 1.1 5G通信システムの進化を支える電子機器の処理能力の向上
 1.2 データ伝送速度の向上とプリント配線板高速化の課題

2. 高周波基板材料に対する要求特性、評価技術と材料設計
 2.1 高速・高周波基板用材料に対する要求特性と技術トレンド
 2.2 信号劣化の要因と誘電特性（誘電率、誘電正接）
 2.3 低誘電損失材料の材料設計
 2.4 次世代通信インフラ向け基板材料の用途、要求特性

3. 高周波基板用部材及び材料の特性とその進歩
 3.1 低損失基板を構成するガラスクロスの特性とその進歩
 3.2 低損失基板を構成する銅箔の特性とその進歩
 3.3 低損失基板を構成するフィラー・添加剤の特性とその進歩

4. 低誘電材料の開発事例とその実際技術
 4.1 精密カチオン重合による可溶性硬化型分岐ポリマーによる
 高周波基板向け低誘電材料の材料設計・開発
 4.2 精密アニオン重合による末端官能基を有する分岐ポリマーの
 合成と硬化型低誘電損失接着性材料の開発

5. 低誘電材料の特性とその技術開発動向
 5.1 熱硬化性芳香族ポリエーテル系樹脂
 5.2 シクロオレフィン系樹脂
 5.3 ポリオレフィン系樹脂

6. まとめ

2. ミリ波通信モジュール用基板材料および パッケージング技術　（須藤　薫　氏）

- はじめに
- パッケージング技術
  - パッケージング構造
  - 放熱構造
- アンテナ技術
  - 広カバレッジ設計
  - 広帯域技術
- 材料技術
  - 基板材料
  - 導体表面粗さ
- 評価技術
- 6Gに向けた取り組み
- まとめ

3. 高速・高周波基板向け低誘電ポリイミド樹脂の 開発動向　（田﨑　崇司　氏）

5G/6G通信やAIサーバーの普及に伴い、高周波対応基板材料には低伝送損失と高信頼性の両立が求められている。本講演では、当社独自の溶剤可溶型ポリイミド樹脂「PIAD」の設計思想と特長を紹介するとともに、低誘電接着剤、低損失FCCL、半導体パッケージ向け材料(RDLなど)への応用事例について解説する。

4. パッケージ基板向け熱硬化性樹脂の 低誘電化技術動向　（高橋　淳　氏）

高周波基板の低誘電特性が物理的限界に近付き、光への転換が進む中、パッケージ基板の重要性が増している。高機能化に伴って基板の大面積化が進み、基板材料に求められるスペックも厳しくなっている中、マトリクスとしての熱硬化性樹脂に求められる課題と、最近の開発動向について解説したい。

＜申し込み要項＞

■申し込み方法：
弊社ホームページ及び講演会パンフレットの申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛まで送信もしくはFAXお願い致します。
申し込み書受領後に、請求書を発送、またWebセミナーの視聴方法について詳細をご案内いたします。
（請求書は開催が決定した場合のみ送付いたします。）

■お支払い：
請求書に記載されている弊社指定口座に、請求日より1ヶ月以内にお振込みをお願い申し上げます。

■キャンセル：
開催日の10日以内のキャンセルにつきましては、全額申し受けさせて頂きます。

■特記事項：
・講演会は受講者数が規定に達しない場合中止する場合があります。
・写真撮影、録音、録画を禁止いたします。

（株）ジャパンマーケティングサーベイ行　FAX: 0120-052-807 or 03-5829-3892

低誘電・低損失材料の技術・開発動向～AI・次世代通信が牽引する高速・高周波材料革新～（66,000円：税込）申込書

2026年12月8日（火）開催　≪Webセミナー≫

年　月　日

申込者名：

企業名：

所属：　役職：

E-mailアドレス：

住所：（〒　）

TEL：　FAX：

連絡事項